证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2024-010

上海南芯半导体科技股份有限公司 修订《公司章程》及修订、制定 部分内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月18日召开了公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司章程修订情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟对《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")进行修订，具体情况如下：

	修改前	修改后
第四十六条	有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会…… (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会…… (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六) 二分之一以上独立董事提议并经董事会审议同意的； (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第一百〇一条	董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换	董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事出席董事会会议的，董事会应当在该事实发生之日起30日内提请召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇二条	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，独立董事人数少于董事会成员的1/3或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。	董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，独立董事人数少于董事会成员的1/3或者董事会专门委员会中独立董事所占的比例不符合公司相关议事规则或者本章程的规定或者独立董事中没有会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 独立董事提出辞职或者被解除职务将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合本章程或公司相关议事规则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自上述事项发生之日起六十日内完成补选。
第一百一十七条	代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日(不包括提议人修改提案或者补充材料的时间)内，召集和主持董事会会议。	代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日(不包括提议人修改提案或者补充材料的时间)内，召集和主持董事会会议。
第一百二十三条	董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。	董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第一百二十八条	专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百三十条	公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。	公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：： (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； (三)聘任或者解聘公司财务负责人； (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第一百三十一条	提名委员会的主要职责是： (一)研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； (二)广泛搜寻合格的董事、总经理及其他高级管理人员人选； (三)对董事候选人、总经理及其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议； (四)法律法规、本章程及提名委员会工作细则规定的其他职责。	公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： (一)提名或者任免董事； (二)聘任或者解聘高级管理人员； 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第一百三十二条	薪酬与考核委员会的主要职责是： (一)研究董事、总经理及其他高管人员考核的标准，进行考核并提出建议； (二)研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案； (三)法律法规、本章程及薪酬与考核委员会工作细则规定的其他职责。	公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使权益条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
第一百三十四条	公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理及其他高级管理人员若干名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员，其中财务负责人需经审计委员会全体成员过半数同意后，再由公司董事会聘任或解聘。
第一百七十三条	公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前聘用会计师事务所。	公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前聘用会计师事务所。

注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

二、修订及制定部分内部管理制度的情况

为进一步规范公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	董事会议事规则	修订	是
2	股东大会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	董事会审计委员会工作细则	修订	否
5	董事会提名委员会工作细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订	否
7	会计师事务所选聘制度	制定	否

本次拟修订的《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的部分制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2024年3月20日

证券代码：688484　　证券简称：南芯科技　　公告编号：2024-009

上海南芯半导体科技股份有限公司 2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司"或"南芯科技")董事会编制2023年度(以下简称"本报告期")募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]365号)，公司获准向社会公开发行人民币普通股63,530,000股，每股发行价格为人民币39.99元，募集资金总额为人民币2,540,564,700.00元，扣除发行费用人民币165,727,598.31元(不含税金额)，实际募集资金净额为人民币2,374,837,101.69元。上述资金已全部到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2023]230Z0068号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币1,533,750,690.15元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	2,540,564,700.00
减：承销保荐费用	139,509,433.96
实际使用补充流动性资金	540,606,013.72
置换先期投入的自筹资金	51,365,538.11
置换先期以自有资金支付的发行费用	5,671,476.41
支付发行费用	20,546,687.94
支付募投项目款项	273,606,809.24
手续费	3,836.83
加：利息收入	24,495,786.36
截至2023年12月31日募集资金专户余额	1,533,750,690.15

二、募集资金管理与存放情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议及专户存储情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，本公司已与保荐人中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，上述三方监管协议均正常履行。

截至2023年12月31日，公司首次公开发行募集资金具体存放情况如下：

募集资金专户开户银行	银行账号	存款方式	2023年12月31日余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801100004415	活期存款	298,336,499.67
中信银行上海分行营业部	8110201013501588062	活期存款	163,592,049.97
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801300004414	活期存款	296,447,856.81
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310608	活期存款	260,781,848.76
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004413	活期存款	283,082,443.90
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121936870310855	活期存款	231,509,878.22
交通银行上海张江支行	310066865013006606294	活期存款	112.82
上海农村商业银行张江科技支行	50131000935063329	活期存款	-
上海银行股份有限公司浦东科技支行	03005244551	活期存款	-
兴业银行股份有限公司上海大柏树支行	216380100100371052	活期存款	-
合计			1,533,750,690.15

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

(二)募投项目的预先投入及置换情况

公司于2023年6月13日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了同意的核查意见。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于2023年5月25日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币12亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等)，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2023年12月31日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年5月25日召开第一届董事会第十五会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币210,000,000.00元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.30%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该议案已经公司2023年6月16日召开的2022年年度股东大会审议通过。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

公司于2023年12月25日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司(含分公司、子公司，下同)在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间，使用自有资金及外汇等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为：公司2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了南芯科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日

附表1：募集资金使用情况对照表

编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司　　2023年年度

单位：人民币 万元

募集资金总额					237,483.71		本年度投入募集资金总额				86,557.83	
变更用途的募集资金总额					-		已累计投入募集资金总额				86,557.83	
变更用途的募集资金总额比例					-							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截期累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项目	无	45,686.45	45,686.45	45,686.45	16,566.90	16,566.90	-29,119.55	36.26	2025年12月	不适用	不适用	否
高集成度AC-DC芯片组研发和产业化项目	无	22,717.78	22,717.78	22,717.78	6,664.00	6,664.00	-16,053.78	29.33	2025年12月	不适用	不适用	否
汽车电子芯片研发和产业化项目	无	33,484.43	33,484.43	33,484.43	7,824.60	7,824.60	-25,659.83	23.37	2025年12月	不适用	不适用	否
测试中心建设项目	无	30,910.82	30,910.82	30,910.82	1,441.73	1,441.73	-29,469.09	4.66	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,060.60	33,060.60	60.60	100.18	不适用	不适用	不适用	否
承诺项目小计	—	165,799.48	165,799.48	165,799.48	65,557.83	65,557.83	-100,241.65	—	—		—	—
超募资金投向												
超募资金永久补充流动资金	—	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	—	50,684.23	50,684.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	71,684.23	71,684.23	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	—	—		—	—
合计	—	237,483.71	237,483.71	186,799.48	86,557.83	86,557.83	-100,241.65	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见"三、本报告期募集资金实际使用情况(二)"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见"三、本报告期募集资金实际使用情况(四)"							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					详见"三、本报告期募集资金实际使用情况(五)"							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					补充流动资金项目承诺投入金额33,000.00万元，报告期内实际投入金额33,060.60万元，实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金账户本年度的利息收入。							

注1：募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

公司代码：688484　　公司简称：南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"中相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基准向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)，截至2023年12月31日，公司总股本42,353万股，以此计算合计拟派发现金红利118,588,400元(含税)。

公司2023年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	南芯科技	688484	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	梁映珍	王蓉
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄54号(4幢)1601	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄54号(4幢)1601
电话	021-50182236	021-50182236
电子信箱	investors@southchip.com	investors@southchip.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

南芯科技是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案。公司现有产品已覆盖移动设备电源管理芯片(含有线充电管理芯片、无线充电管理芯片、锂电管理芯片、其他移动设备电源管理芯片)、通用电源管理芯片、适配器电源管理芯片、汽车电子芯片通过打造完整的产品矩阵，满足客户系统应用需求。公司产品主要应用于手机、笔记本/平板电脑、电源适配器、智能穿戴设备等消费电子领域，储能电源、电动工具等工业领域及车载领域，部分终端应用情况如下：

公司主要产品情况如下：

产品类别		产品介绍
移动设备电源管理芯片	有线充电管理芯片	采用降压/升压斩波/开关电容等拓扑进行电压电流的转换控制，支持从10W到300W的充电功率。产品支持单串到多串的电池供电系统，并且包括多串电池升降压的充放电管理。
	无线充电管理芯片	利用电磁感应原理，在没有实体电线连接的情况下，通过控制初级和次级线圈感应产生的电流，将能量从发射端无接触传输到接收端，并通过无线通信协议对传输能量进行控制，从而为用电设备进行安全充电
	锂电管理芯片	实现对锂电池电芯充放电状态的监测和保护，对电量进行管理，避免电芯出现过充、过放、温度过高等异常情况，提高电芯性能和使用寿命
	其他移动设备电源管理芯片	
通用电源管理芯片	通用电源管理芯片	包括开关充电芯片和线性充电芯片，对单节和多节锂电池进行充电管理，广泛应用在各种消费和工业市场领域，为便携式设备进行充电
适配器电源管理芯片	AC-DC芯片	实现交流电向直流电的转换。通过整流控制器将工频交流电转换为脉动直流电，再通过滤波电路将脉动直流中的交流成分滤除，减少交流成分；增加直流成分，并通过负反馈系统控制，对整流后的直流电压进一步进行调制和稳压
	协议芯片	实现充电器和终端用电设备之间就各自USB端口所支持的快充协议，充电能力和所需充电功率进行通讯。并进行相应的快充申请和控制，实时传递充电状态信息，进行USB端口充电状态监测和保护，是快充得以实现的基础
	其他适配器电源管理芯片	
汽车电子芯片	DC-DC芯片	通过高频、周期性控制电力电子开关器件的开关，将输入直流电压转换为另一个直流电压，并通过负反馈系统控制，实现输出电压调整稳压的功能，广泛应用在消费、工业和汽车等各领域
	其他汽车电子芯片	

公司以"成为全球领先的模拟与嵌入式芯片企业"为经营愿景，凭借高效的研发能力、卓越的技术创新能力以及严苛的品质管控能力，在消费电子、工业及汽车电子领域推出高性能电源及电池管理芯片，助力国产芯片自主可控。公司与上游晶圆制造商、封装测试厂商等供应商建立了高效的联动机制和长期稳定的合作关系，提高了公司的供应链能力；公司与终端品牌客户建立了日益紧密的伙伴关系，在良好的合作中及时了解需求端技术新方向、新动态，针对性地对产品进行研发迭代，从而提高研发效率。未来，公司将继续加强技术积淀，加大研发投入，持续对现有产品进行迭代升级，不断丰富产品矩阵，提升在消费电子领域的优势，进一步拓展在工业和汽车电子领域的应用，致力于成为全球领先的模拟与嵌入式芯片企业。

(二)主要经营模式

报告期内，公司经营模式无重大变化。公司采用的经营模式为行业同行的Fabless模式，主要专注于芯片的设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

1、研发模式

公司采用Fabless的经营模式，产品设计及研发是公司业务的核心。公司高度重视研发创新体制的建设与管理，长期致力于建立规范化的产品研发流程及质量控制体系，确保各产品系列在研发的各个阶段均能够实现优质的产品设计、有效的质量保障及可靠的风险管理。公司具体研发流程包括立项阶段、项目设计阶段、产品验证及量产阶段等业务流程，确保产品的研发和验证过程都得以有效的控制和管理。

2、采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售，通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试，公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动，灵活高效等特点。

在Fabless模式中，公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控，产品的生产则采用委外加工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前，公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务，公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

3、销售模式

公司目前采用"经销为主，直销为辅"的销售模式，即公司既通过经销商销售产品，又向终端厂商直接销售产品。直销模式是指公司直接将产品销售给终端客户，经销模式是指公司将产品买断性地销售给经销商。

(三)所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、所属行业

公司主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，所处行业属于集成电路设计行业。根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》，公司所属行业为"制造业"中的"计算机、通信和其他电子设备制造业"，行业代码为"C39"。公司所处的集成电路设计行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》所规定的鼓励类产业，政府主管部门为工信部，行业自律性组织为中国半导体行业协会。

2、行业发展概况

(1)集成电路行业

集成电路行业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。集成电路产品根据功能主要可分为数字芯片和模拟芯片，其中数字芯片指基于数字逻辑设计和运行的，用于处理数字信号的集成电路芯片，包括微元件、存储器和逻辑芯片适配器电源管理芯片；模拟芯片指处理连续性模拟信号的集成电路芯片。

由于2023年的第二季度和第三季度市场表现略好于之前预期，2023年11月底，世界半导体贸易统计组织(WSTS)上调了2023年全球半导体市场规模的预测，从此前的5,150亿美元调整至5,201亿美元，2023年全球半导体市场较2022年同比下降9.4%。

根据WSTS预测，2024年全球各地区半导体市场都将有所回暖，特别是美洲和亚太地区，将实现两位数以上的增长。预计2024年全球半导体市场将实现强劲复苏，预测增长13.1%至5,884亿美元。

长期来看，全球及中国集成电路产业仍将持续增长。近年来蓬勃发展的新能源车、5G、自动驾驶、数据中心、工业自动化、人工智能、物联网、可穿戴设备等新兴产业将形成强大的未来需求。未来几年通信、消费电子、数据中心等领域成长率减缓，而车用和工业用领域成长较快。

我国是全球最大的集成电路需求市场，特别是对价值较高的高端芯片进口依赖仍较大，芯片进口金额远超出口金额，显示我国在芯片领域存在大量的进口替代空间。我国高端集成电路产业实现自主可控、进口替代，成为了亟待解决的问题。为推动芯片国产化进程，2015年5月，国务院发布《中国制造2025》提出2025年芯片自给率要达到70%的发展目标。

根据国家统计局发布的2023年国民经济和社会发展统计公报，我国2023年全年集成电路产量3,514.4亿块，比上年提升6.9%；全年集成电路出口2,678亿个，比上年下降1.8%，金额为9,568亿元，比上年下降5.0%，在我国主要商品出口中金额排名第四；集成电路进口4,796亿个，比上年下降10.8%，金额为24,591亿元，比上年下降10.6%，在我国主要商品进口中金额排名第一。

(2)模拟芯片行业

模拟集成电路产品的生命周期较长，下游应用广泛且分散，是整个市场发展的晴雨表。得益于行业本身的技术积累和消费电子、智能家居、智能安防、汽车电子、工业控制等下游应用领域的发展，模拟集成电路行业保持稳定发展。根据WSTS预测，全球模拟芯片2024年市场规模将实现841亿美元，较2023年同比增长3.7%。

2023年，中国模拟芯片市场增速有所放缓，但预计规模将超过3000亿元人民币，占全球模拟芯片市场规模50%以上，中短期内中国仍将是全球最大的模拟芯片消费市场。

随着国内汽车、工业、通信等领域对模拟芯片的应用需求拉动，以及国产模拟芯片有较大国产化率的提升空间，未来中国模拟芯片市场将持续增长。

3、行业技术水平及特点

在大功率充电方面，以手机为代表的消费终端充电功率逐步提升，常规的18W充电功率已逐步被33W取代，部分高端机型、旗舰机型已推出200W及以上充电功率，带动大功率充电的渗透率和充电功率持续提升。

在小型化充电方面，第三代半导体技术和高集成度方案使得适配器功率密度提升，外围器件减少，小型化充电方案成为市场趋势。

在端到端完整解决方案方面，完整解决方案能够降低终端厂商系统成本，减少终端厂商产品开发周期。对芯片厂商来说，提供端到端完整解决方案需要芯片厂商对整个系统有充分的理解，突破单款产品研发的局限，对芯片厂商的要求较高。

4、主要技术门槛

公司产品下游应用包括手机、笔记本电脑等高端消费领域，汽车及工业领域。其中手机内部电源管理芯片因对其体积、稳定性、一致性要求较高，且公司产品主要用于充电管理及电池管理，对安全及性能要求较高；汽车及工业级应用场景对芯片要求较高。因此，公司所处行业存在较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)公司是国内少数在细分领域能与同行业国际大厂直接竞争并实现高端产品国产替代的公司之一

全球拥有突出研发实力和规模化运营能力的模拟与嵌入式芯片公司主要集中在海外，南芯科技是国内在电源及电池管理领域少数能与国际大厂直接竞争并实现高端产品国产替代的公司之一。在手机等消费电子应用领域，公司直接与同行业国际大厂竞争，并取代了部分国际大厂市场份额，助力芯片国产替代。在以充电管理芯片为代表的产品中，公